



Bedienung von Geräten im Elektroniklabor

Löten von SMD-Bauteilen mit dem Reflow-Ofen

Electronics Laboratory

Regensburg University of Applied Sciences

Regensburg

Reflow Löten

Lötpaste aufbringen

Für druckluft zur Basisstation des Lötpaste-Dispensers sorgen: Drucklufthebel öffnen (grüner Hebel neben der Tür) → Druckluftanzeige and der Techcon Basisstation beachten.

- Lötpaste in den Dispenser geben (durchsichtiges Rohr mit Schlauch)
- Aufbringdauer der Lötpaste auf 150ms einstellen (im Display 0.150S)
- Unter dem Mikroskop die Spitze der Dispenser-nadel auf das Pad halten
- Fusstaste betätigen (Man sieht unter dem Mikroskop wie ein Lötpastetropfen kommt).

Bauteile aufbringen

- Die Lötpaste ist auf den Pads, auf denen die SMD-bauteile festgelötet werden sollen.
- SMD-Bauteil mit Pinzette aufnehmen, sie unter dem Mikroskop mit den lötbaren Enden auf Lötpastetropfen setzen.
- Kurzschlüsse aus Lötpaste über Lötstopplack können in Kauf genommen werden, denn beim Lötprozess zieht sich Lötpaste auf die Pads.

Reflow Ofen bedienen

Enschalten am Kippschalter rechts vorn

Display oben beachten:

"PROFILE" auswählen (ist default), bestätigen mit Taste >

"LF SMALL" auswählen, bestätigen mit Taste >

"START PROFILE" auswählen, bestätigen mit Taste > (Ofen heizt nun auf 170°C)

Display zeigt:

→ "WARMUP"

"OPEN DRAWER & INSERT PCB" (Schublade ziehen und Leiterplatte auf die beiden Stangen legen)

→ "INSERT pcb & CLOSE DRAWER" (Leiterplatte einlegen und Schublade zudrücken)

→ "PREHEAT" (ca. 120s) –(automatisch)→ "REFLOW" (90s) –(auto)→

→ "OPEN DRAWER Drawer" (Schublade herausziehen) –(auto)→

→ "Cooldown" (ca. 80s) –(auto)→

→ "REMOVE PCB & CLOSE DRAWER" (PCB herausnehmen (heiß, Pinzette), schließen.)